

Fabbrica di wafer di Reutlingen

2021

- ▶ **Strutture di produzione** Tecnologia 50 mm dal 1995; tecnologia 200 mm dal 2010;
Test center per i semiconduttori;
I semiconduttori sono prodotti nella fabbrica di wafer di Reutlingen dal 1971.
- ▶ **Superfici clean-room** 35.000 m²
Altri 1.000 m² saranno disponibili nell'autunno del 2021.
- ▶ **Collaboratori** 3.500
- ▶ **Tecnologia di produzione** Substrati in silicio (wafer) da 150 e 200, con larghezze strutturali (nodi) fino a 180 micron; 1 micron corrisponde a un milionesimo di mm
Substrati in silicio (wafer) da 150 mm, con larghezze strutturali (nodi) fino a 400 micron.
- ▶ **Prodotti realizzati** Circuiti integrati specifici per applicazione (ASIC), sistemi micro-elettromeccanici (MEMS), semiconduttori di potenza.
- ▶ **Campi di applicazione dei semiconduttori** Elettronica per autoveicoli: Sistema elettronico di stabilità ESC, centraline elettroniche per motori a combustione interna e motori elettrici e per le trasmissioni, airbag e sistemi di assistenza alla guida, park assist e sistemi di potenziamento della visione notturna. Elettronica di consumo: smartphone, laptop, wearable, hearable, console di gioco, droni.